

決算説明会

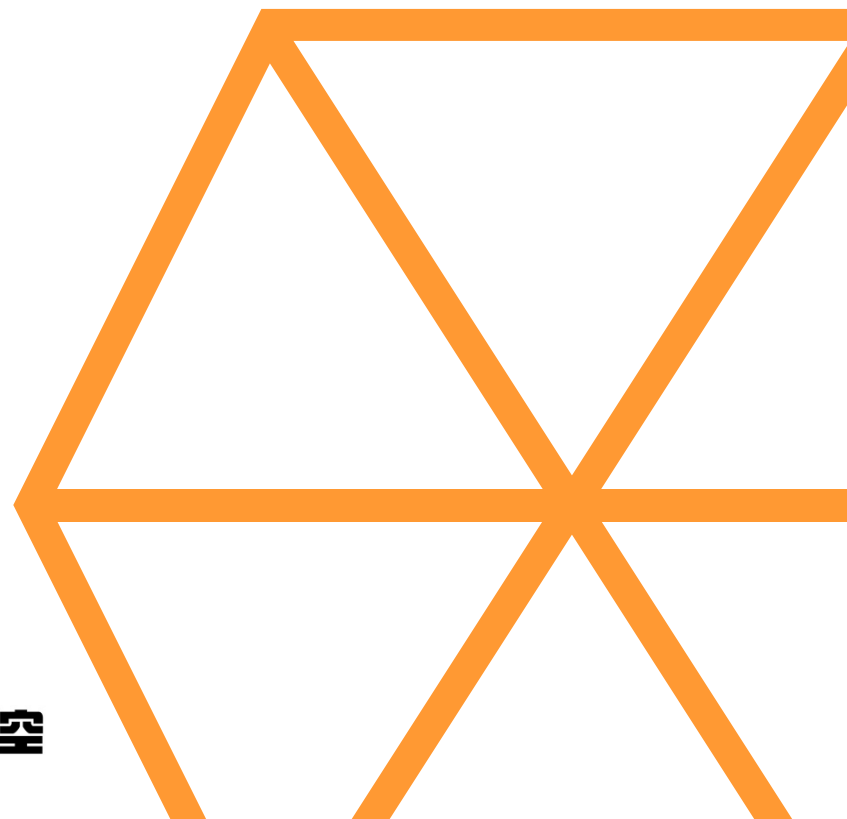
2022年3月期 第2四半期決算

2021年11月30日

株式会社 大真空 （証券コード：6962）

代表取締役社長 飯塚 実

株式会社 **大真空**



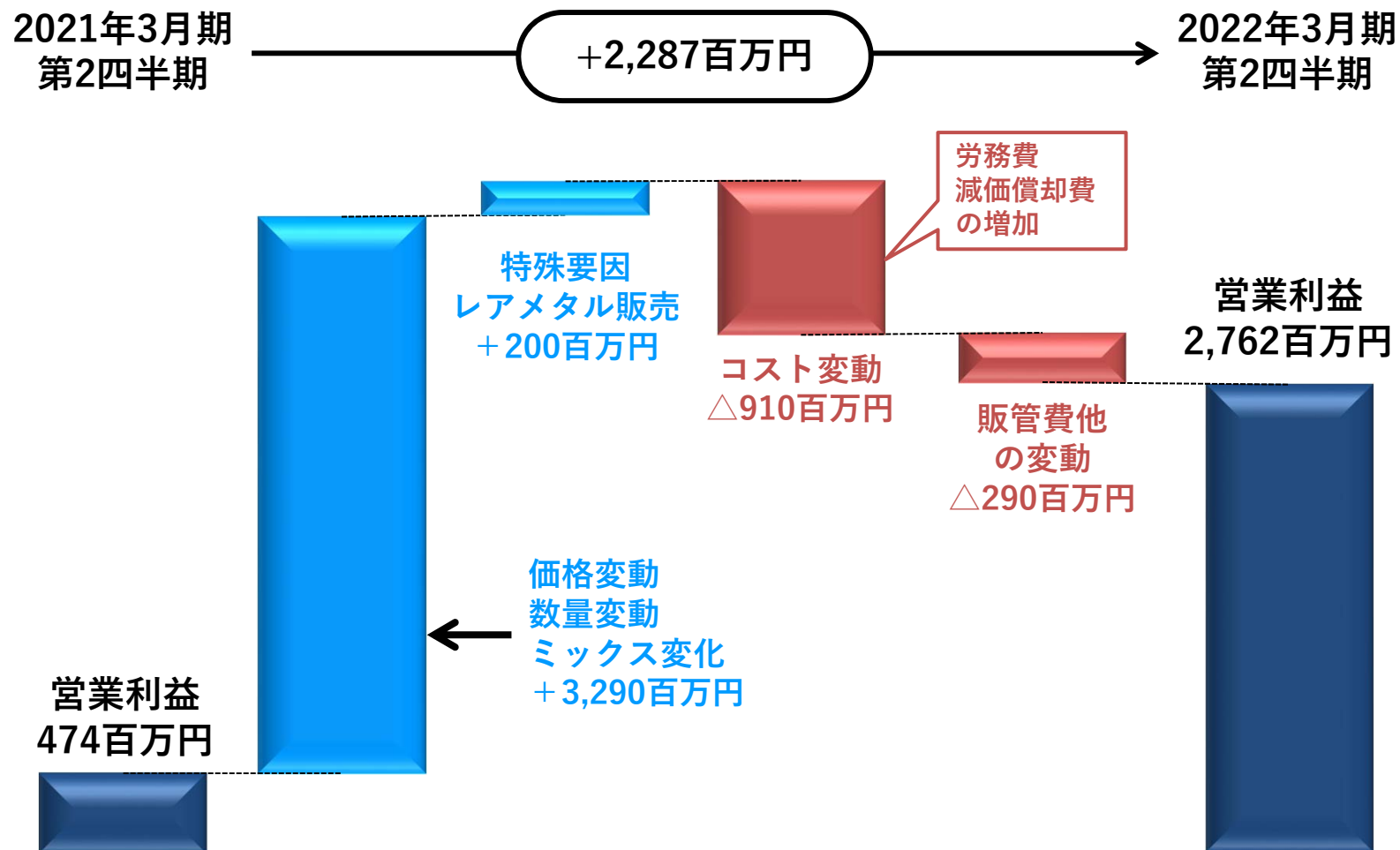
2022年3月期 第2四半期業績報告

過去最高益

単位：百万円

	2021年3月期 第2四半期	2022年3月期 第2四半期	前年同期比	
			増減	増減率
売上高	14,463	21,434	+6,971 ↑	+48.2%
営業利益	474	2,762	+2,288 ↑	+481.7%
経常利益	433	3,042	+2,609 ↑	+602.4%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	105	1,773	+1,668 ↑	+1,578.9%
USD平均レート（円）	106.93円	109.81円	+2.88円 ↑	-

営業利益 増減分析(前年同期比)



四半期 業績報告

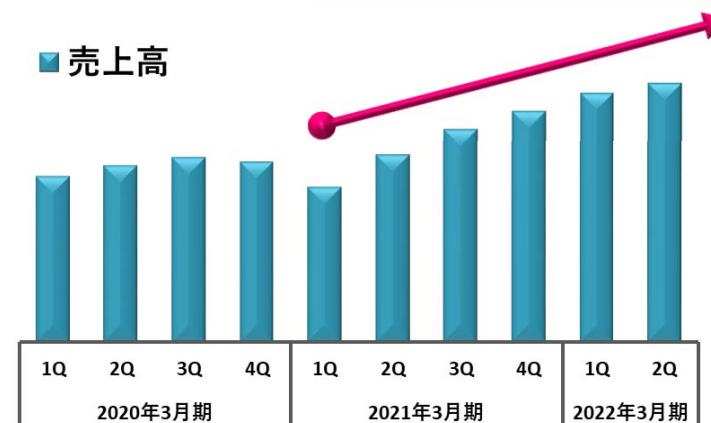
過去最高益

単位：百万円

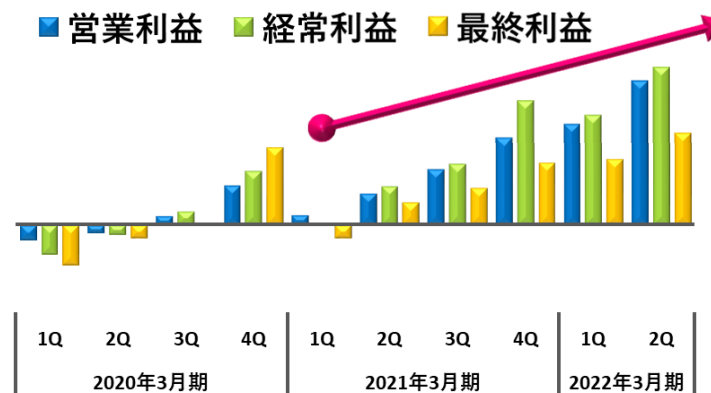
	2022年3月期	2022年3月期	直前四半期比	
	4-6月	7-9月	増減	増減率
売上高	10,507	10,927	+420 ↑	+4.0%
営業利益	1,137	1,625	+488 ↑	+42.9%
経常利益	1,234	1,808	+574 ↑	+46.3%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	740	1,033	+293 ↑	+39.5%
USD平均レート (円)	109.52円	110.11円	+0.59円 ↑	-

5四半期 連続増収増益 (連続増益は、営業利益/最終利益)

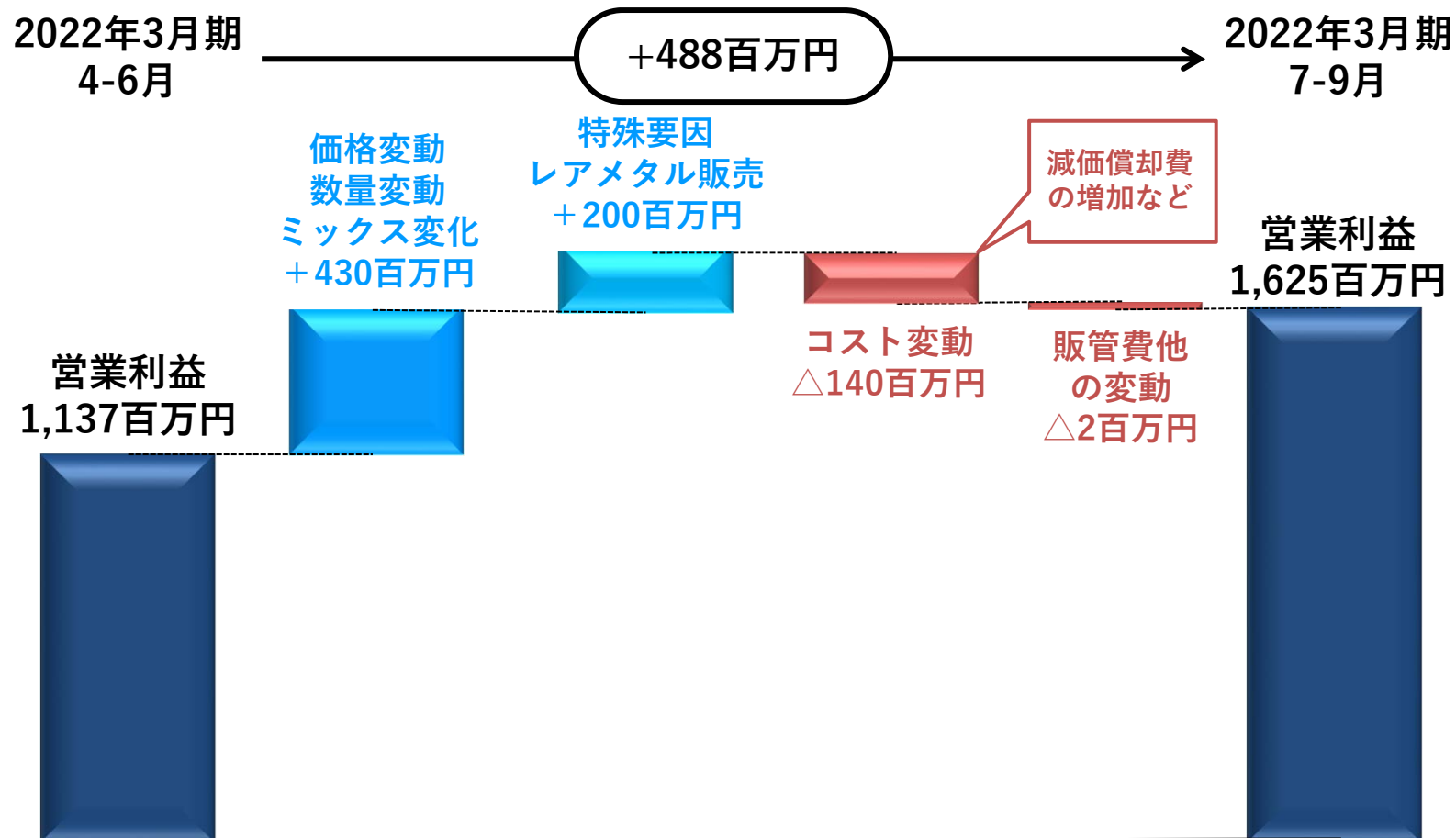
■ 売上高



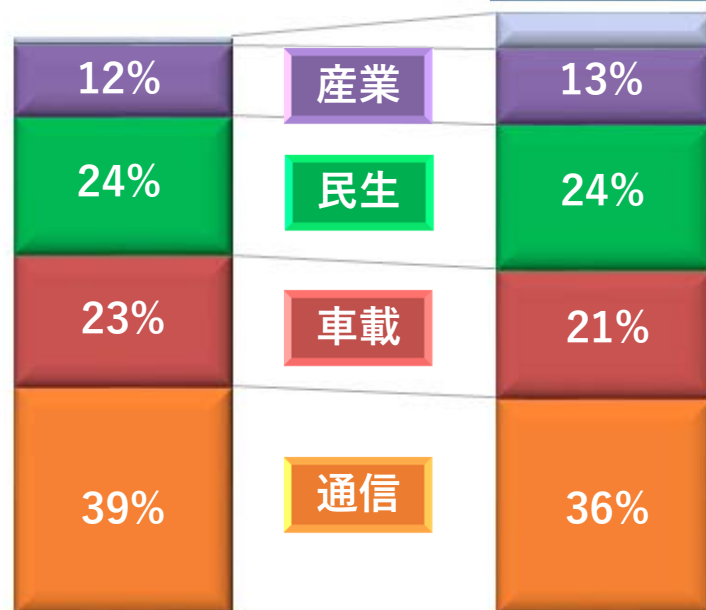
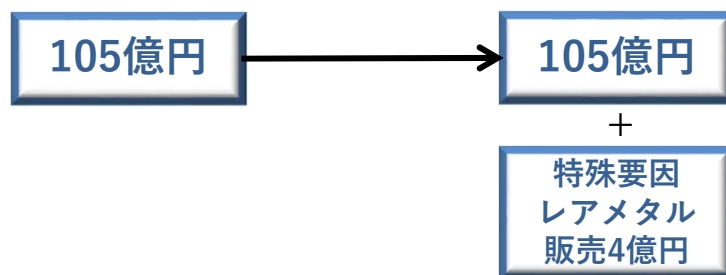
■ 営業利益 ■ 経常利益 ■ 最終利益



営業利益 増減分析(直前四半期比)



用途別販売実績（直前四半期比）



2022年3月期4-6月

2022年3月期7-9月

※売上高構成比

産業 直前四半期比 +6%

・FA/ロボットや住宅関連向けが増加

民生 直前四半期比 +4%

・PC関連機器やタブレット端末の好調さが継続

車載 直前四半期比 △2%

・一部の地域で半導体不足の影響があったもののADAS向けや電装化は進展

通信 直前四半期比 △5%

・5Gスマホ端末は堅調に推移するも一部で半導体不足の影響が顕在化

※絶対金額の増減比

設備投資／減価償却費／研究開発費

前年同期比

	2021年3月期 第2四半期	2022年3月期 第2四半期	単位：百万円 増減
設備投資	2,153	2,666	+513 ↑
減価償却費	1,374	1,659	+285 ↑
研究開発費	1,030	1,042	+12 ↑

主な設備投資

フォトリソ関連設備
(ウエハ/組立て増強、開発)
超小型水晶振動子増産設備
加高電子タイ第2工場

直前四半期比

	2022年3月期 4-6月	2022年3月期 7-9月	増減
設備投資	1,424	1,242	-182 ↓
減価償却費	810	849	+39 ↑
研究開発費	520	522	+2 ↑

主な研究開発

次世代高周波水晶デバイス
Arkhシリーズ
大型水晶原石
ウエハの大判化

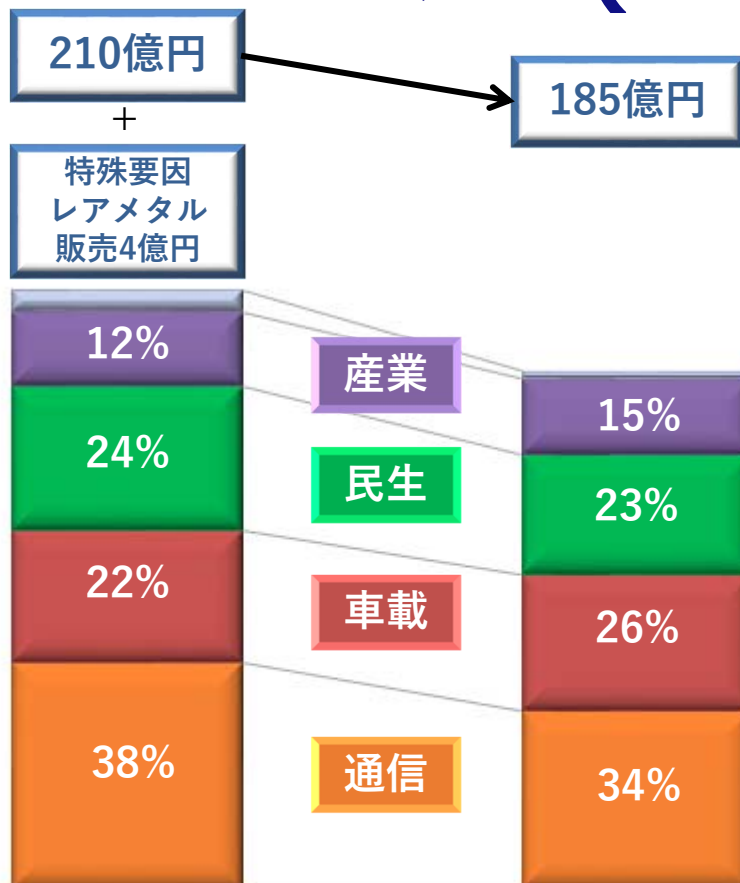
通期業績予想

上方修正

単位：百万円

	2021年3月期	2022年3月期		
	通期	上期実績	下期予想	通期予想
売上高	33,189	21,434	18,566	40,000
営業利益	2,089	2,762	2,038	4,800
経常利益	2,533	3,042	1,958	5,000
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,223	1,773	627	2,400
USD平均レート（円）	106.10円	109.81円	110.00円	
設備投資	4,355	2,666	6,334	9,000
減価償却費	2,921	1,659	1,941	3,600
研究開発費	2,048	1,042	1,358	2,400

マーケット見通し(上期実績対下期予想)



2022年3月期上期

2022年3月期下期

※売上高構成比

※絶対金額の増減比

産業 直前半期比+3%

・上期に引き続き、一定の水準で推移

民生 直前半期比 △17%

・半導体不足の影響や季節要因を見込む

車載 直前半期比 +2%

・ADAS向けや電装化の進展は継続

通信 直前半期比 △21%

・半導体不足の影響

➡ 期初より上期偏重で想定しており、その見通しは変わらず

株式会社 **大真空**

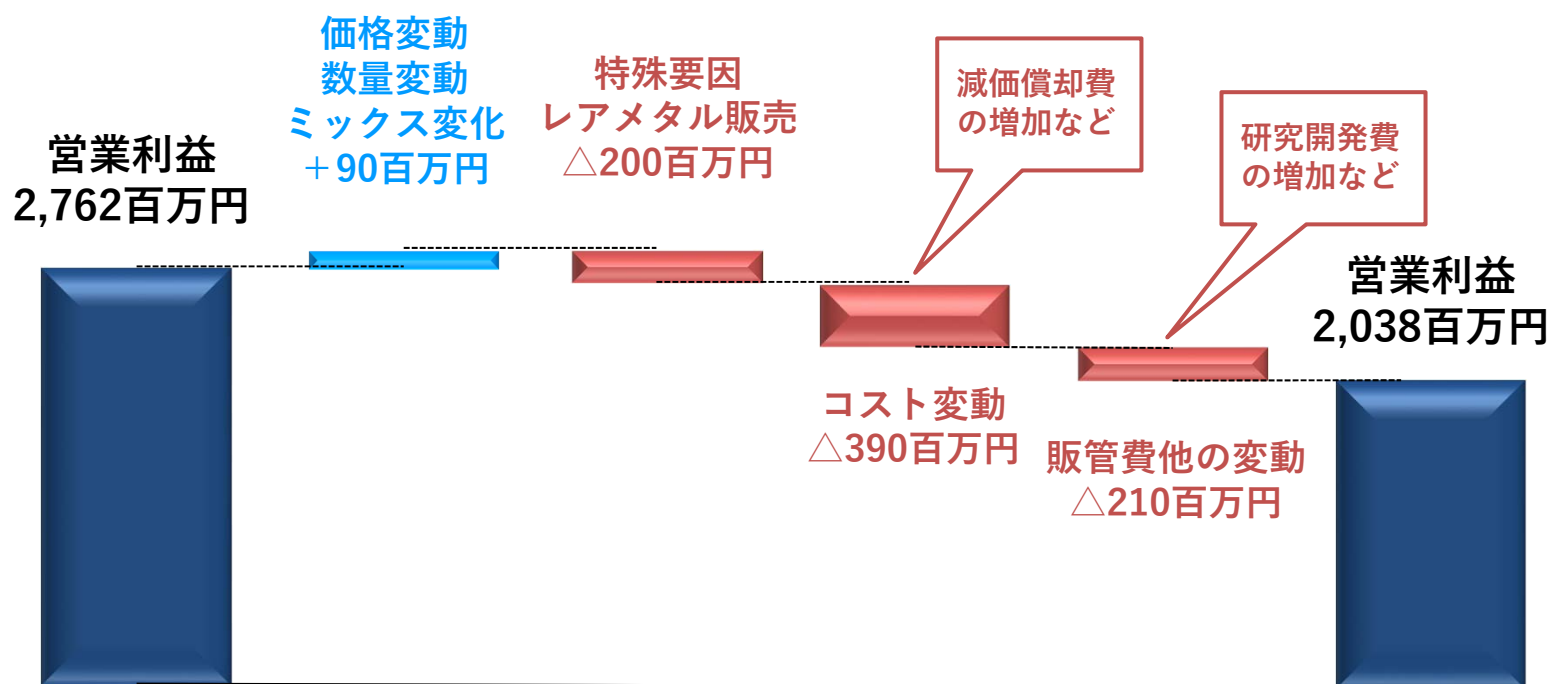
営業利益 増減分析(上期実績対下期予想)

売上高増減：△2,868百万円

2022年3月期上期

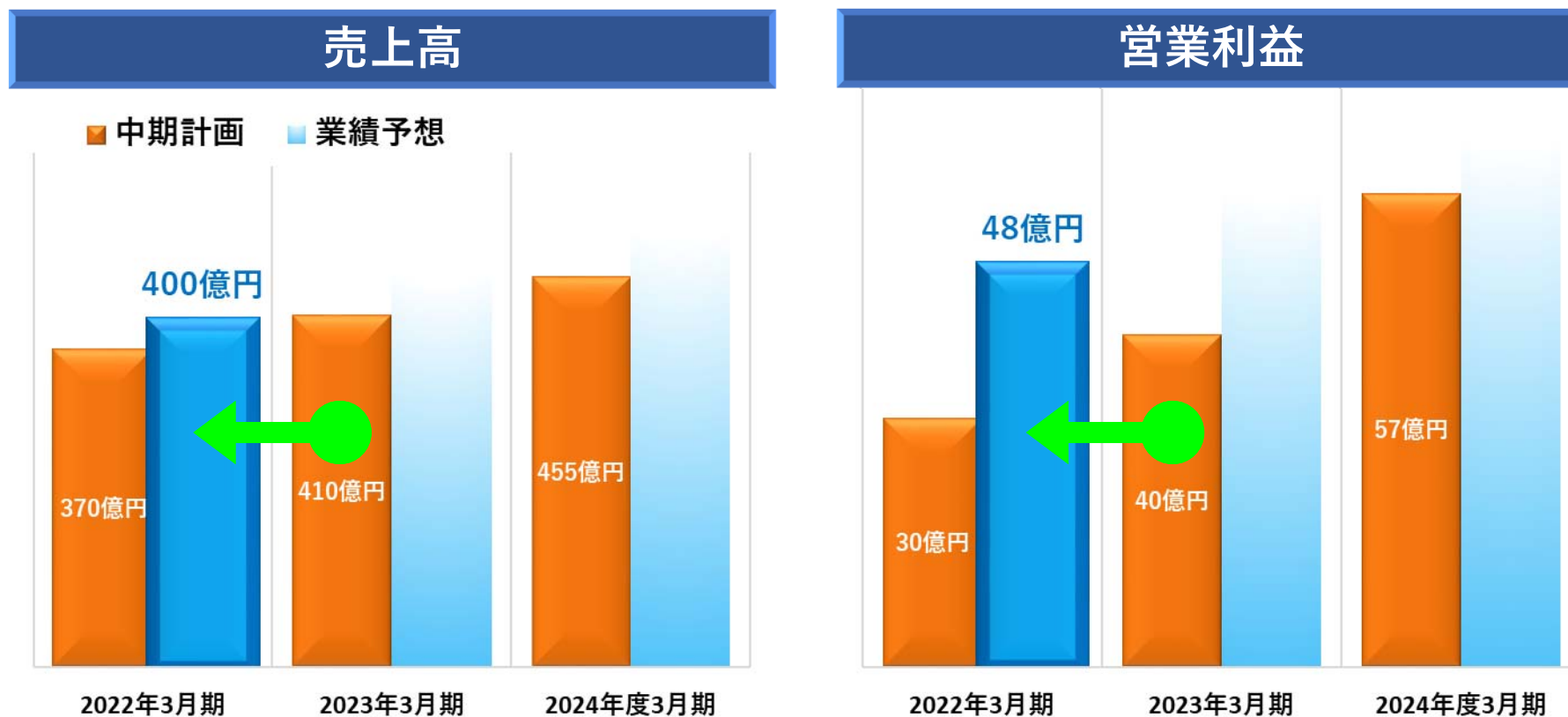
△724百万円

2022年3月期下期



第1中期経営計画の進捗

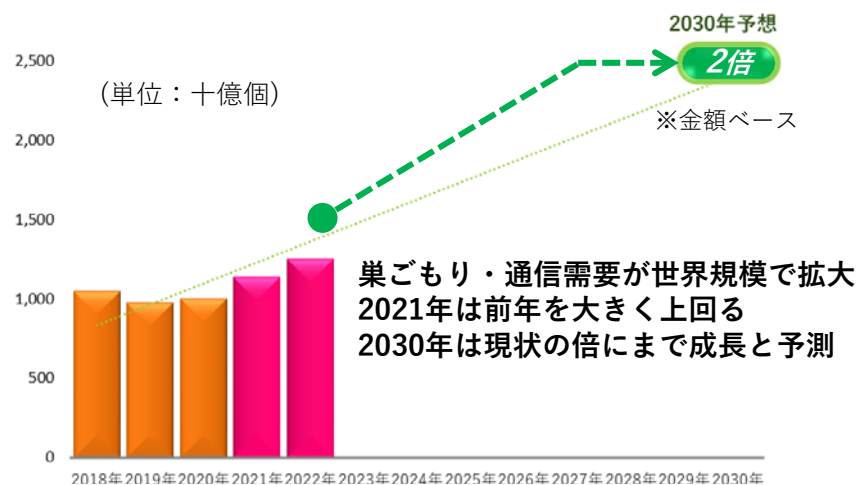
※第1中期計画：2021年当社制定



第1中期計画に対し、繰り上げ遂行中
中計2年目の早期到達を目指す

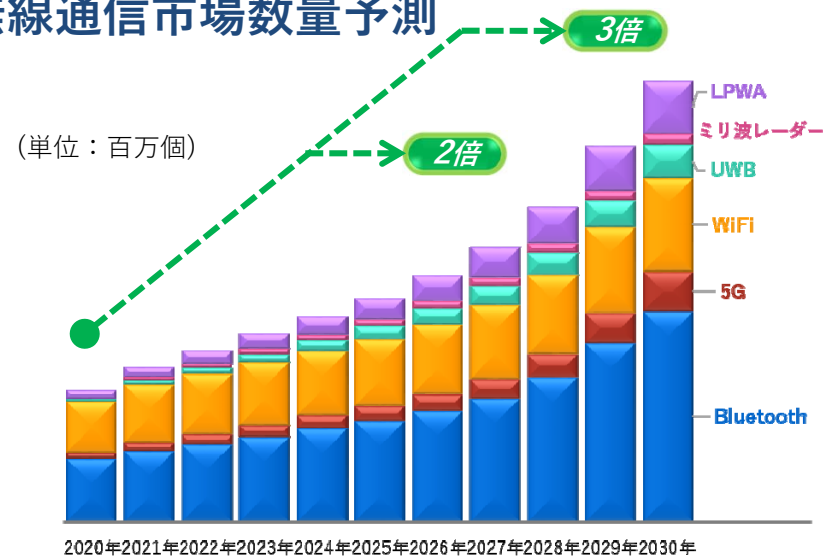
繰り上げ遂行の背景

半導体市場数量予測



※IC Insight、WSTS、経済産業省資料ほかより、当社推定

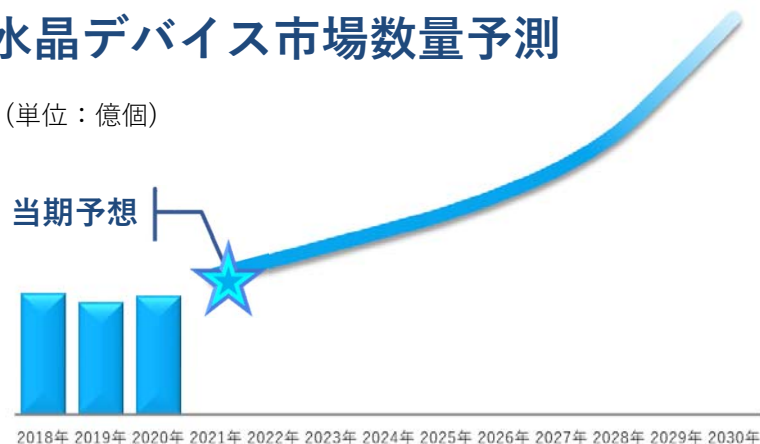
無線通信市場数量予測



※富士キメラ、テクノシステムリサーチより、当社推定

水晶デバイス市場数量予測

(単位：億個)



※日本水晶デバイス工業会データより、当社推定

5G・WiFi・Bluetooth 膨大な数量増

- 5G・WiFi向け → MHz帯フォト振動子
- IoT全般向け → kHz帯フォト振動子
- IoT全般向け → MHz帯振動子

数量増への対応【既存品アプローチ】

5G・WiFi・IoT全般向け水晶デバイス



MHz帯フォト振動子

kHz帯フォト振動子

MHz帯振動子



生産設備改革によるOutputの最大化と環境配慮
「フレキシブル&フルオート」製造ライン開発中

目標(当社従来比)：設備能力 約**2.5**倍、装置面積 約**50%**



増床なしで
アウトプット
約**5**倍

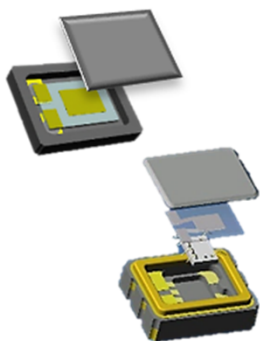
完全自動化に向けたロボット検証中

- 多関節ロボット
- 自走型ロボット



数量増への対応【開発品アプローチ】

従来品



外部調達部品：リッド ベース IC サーマスタ

外部調達部品
構成比
約**70%**

セラミックパッケージの用途

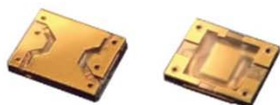
※気密封止が可能 ※高精度デバイスに必要

- MEMSセンサー／イメージセンサー
- 光通信モジュール
- 半導体用パッケージ
- 水晶デバイス用パッケージ

需要急増による
部材入手難

当社の対応

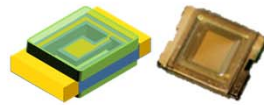
 Arkh.3G



外部調達部品
構成比

0%

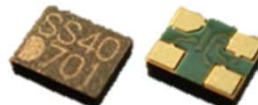
 Arkh.4G



樹脂製フィルム
接着剤不使用

直材費低減

モールド発振器



モールド技術の
水晶への展開

リードタイム短縮

環境に配慮した持続
可能な社会実現へ

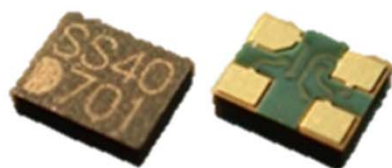


SDGs

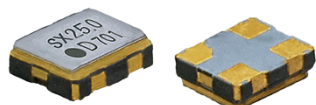
Ark Series 新展開

Ark Series + 樹脂モールドの融合

樹脂モールド製品



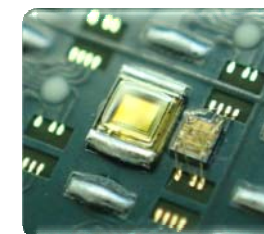
【参考 当社従来品】
DSO211SXF



自社モールド発振器へ Ark Series を内蔵し、
市場実績の蓄積を加速させる



コスト・環境・納期を追求

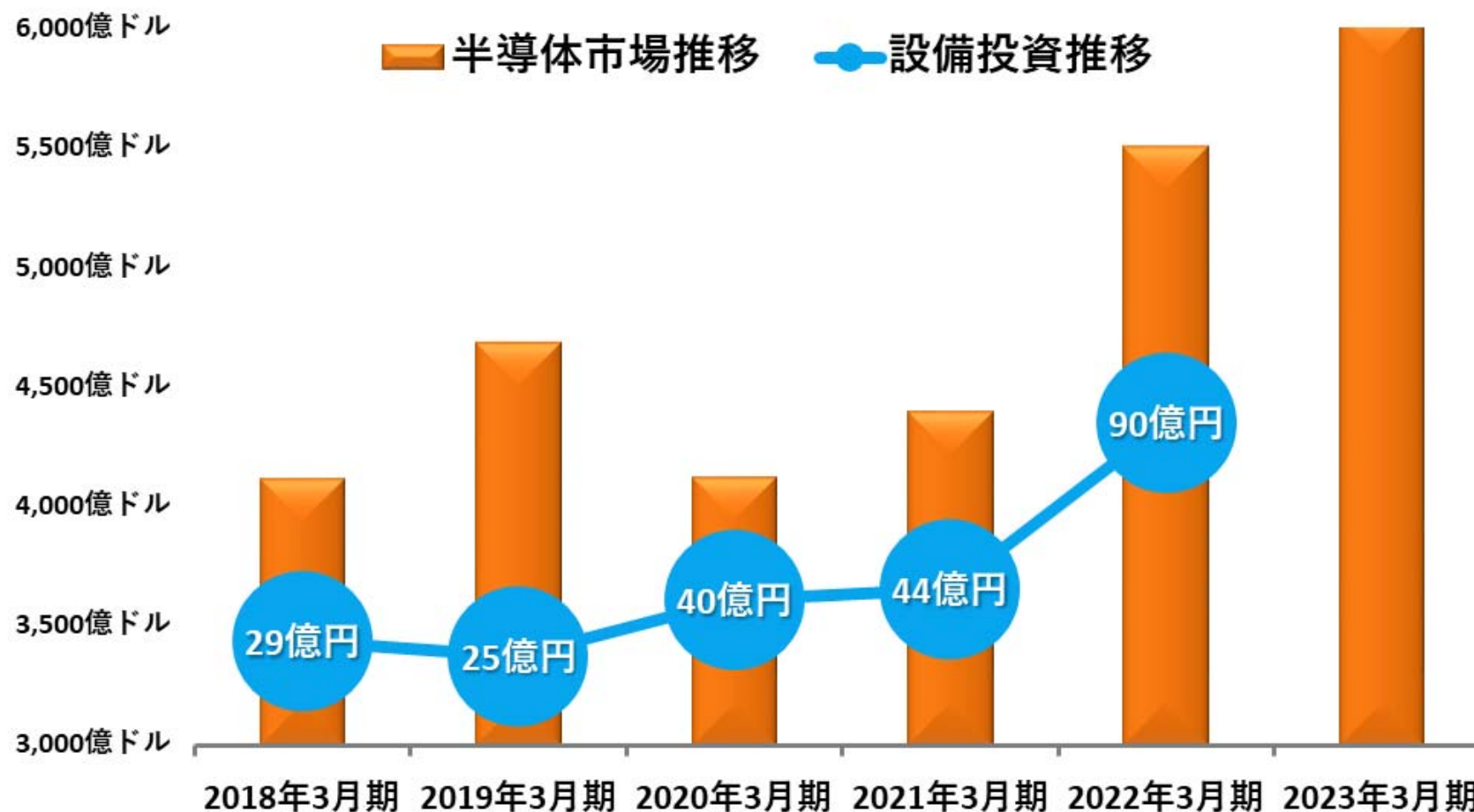


モールド発振器群として、多品種を同時開発中
来期の市場投入を予定

- 過去 ICは、セラミックからモールド化へ変化
- 水晶のモールド化は通常出来ないが、Ark Series 内蔵により これを実現

設備投資推移

市場拡大に備え、2022年3月期 90億円投資を実行予定



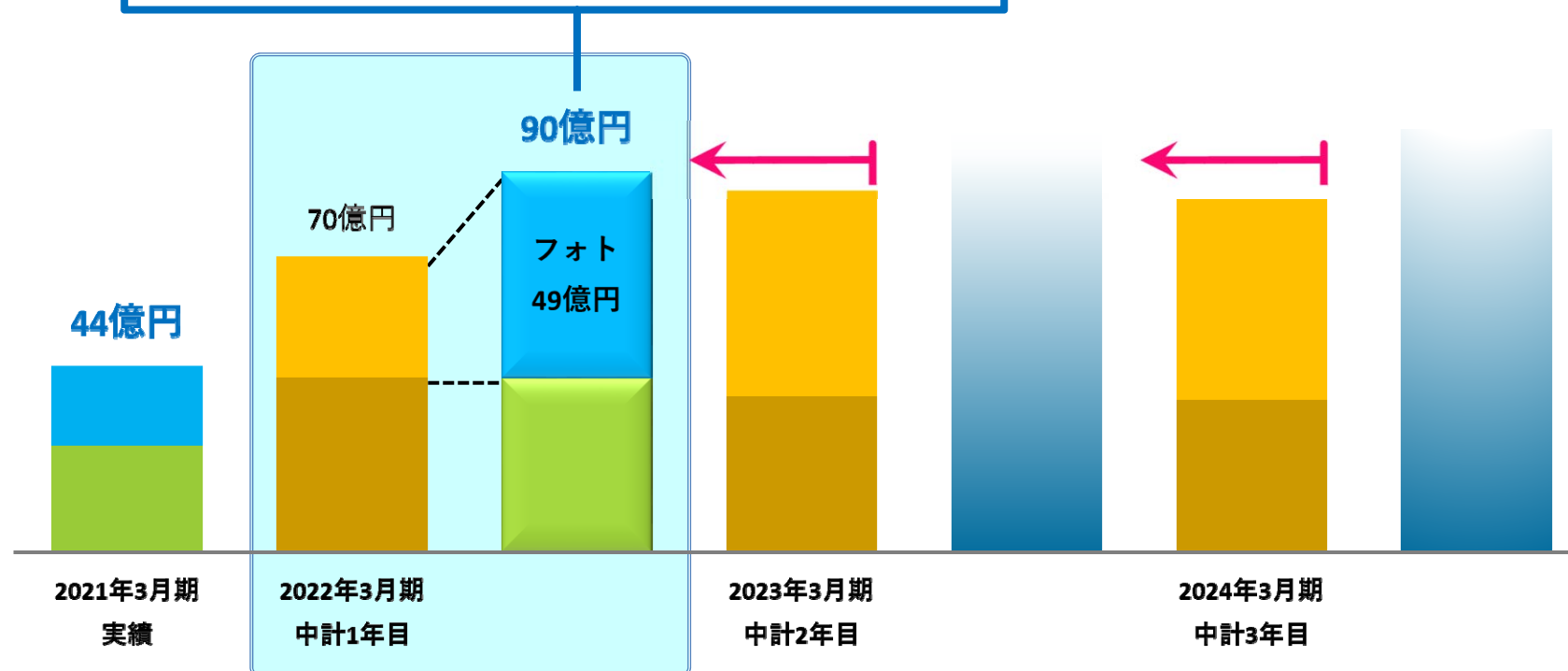
当期設備投資計画

当初計画の70億円から **90億円**に増額

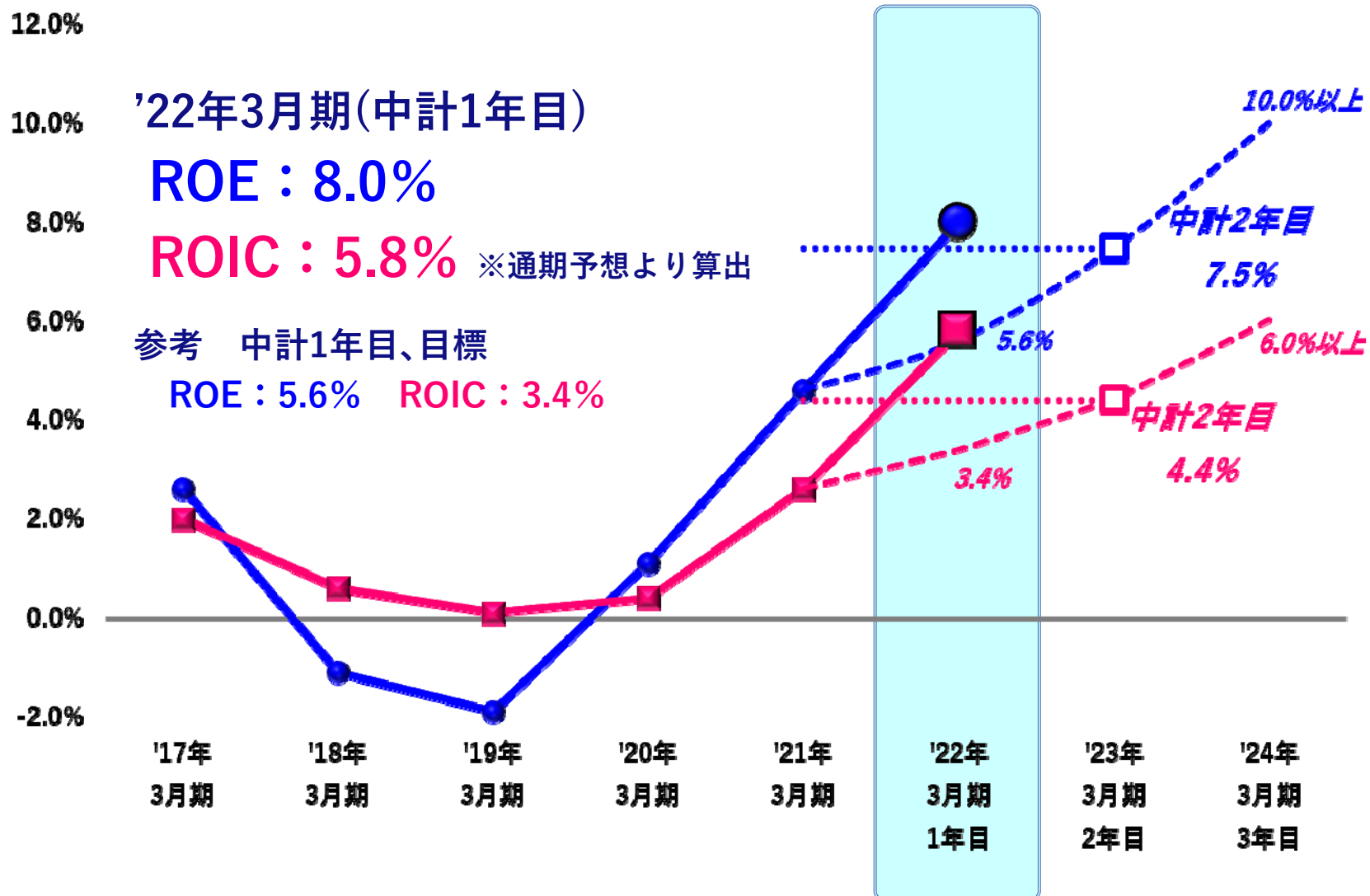
5G/WiFi/IoT向け
フォト設備
39億円

車載向け等
MHz帯設備
32億円

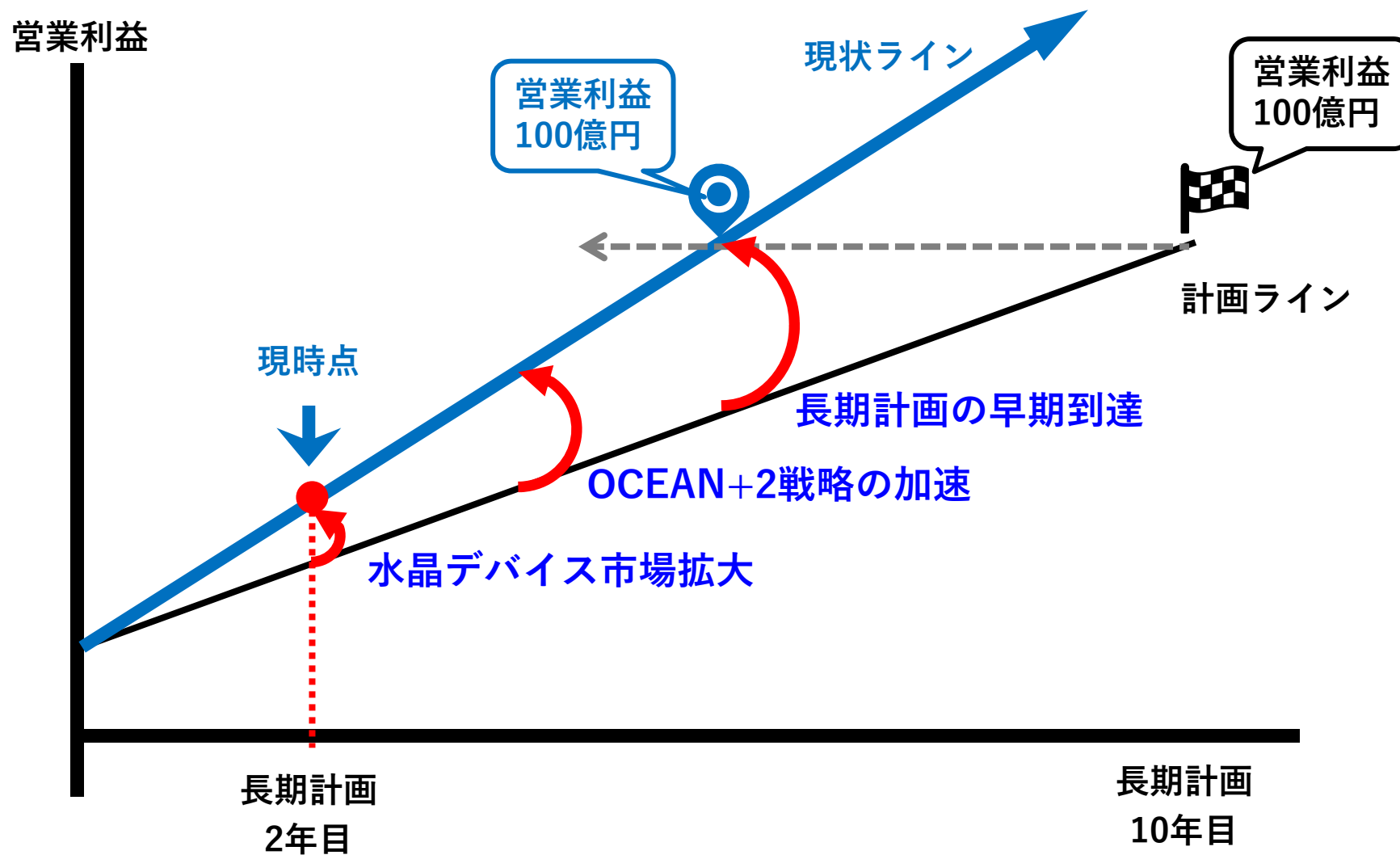
Ark、フォト
研究開発ほか
19億円



経営指標 ROE/ROIC 予想



長期10年経営計画 成長イメージ



今期見通しと来期への準備



- 半導体不足により 2Q~4Qに影響を受ける
- 下期は一旦落ちるが、計画通りの進捗
- この間に次の成長エンジンを準備

次の成長エンジン

モールド製品

7050~2016サイズ
モールド発振器

RTC発振器

差動発振器

既存製品

32kHz TCXO

超高精度
TCXO

Arkhシリーズ

Arkh.3G

Arkh.4G

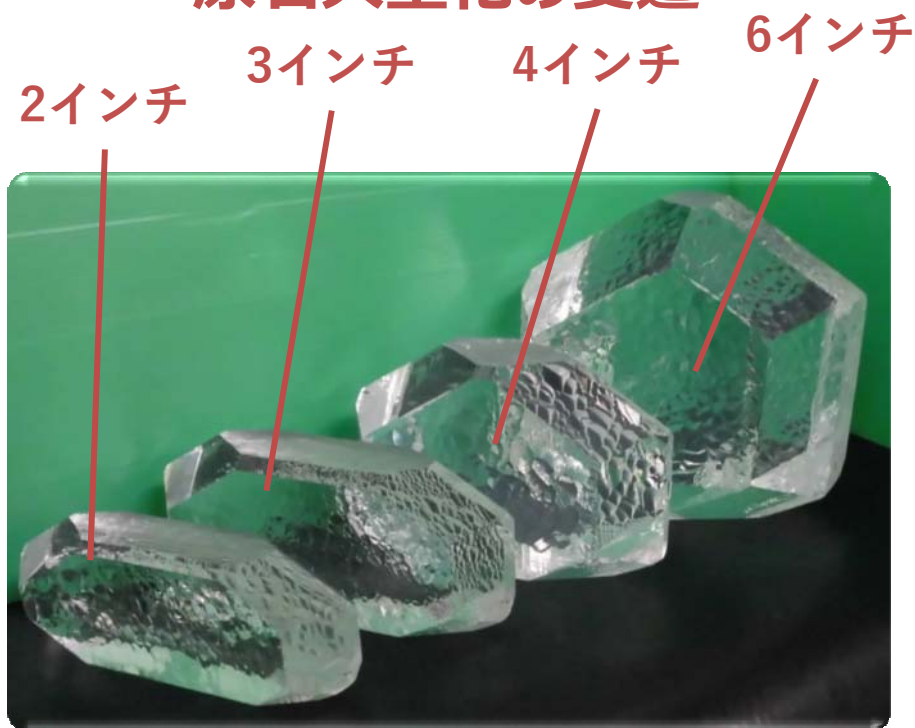
Arkh.5G

今後の水晶業界 成長の源泉

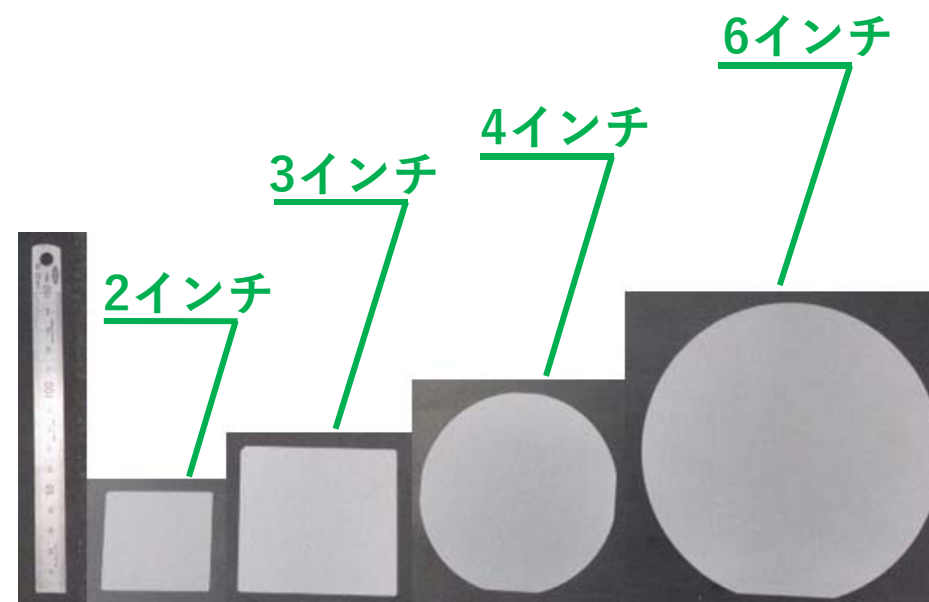
成長エンジンに大型ウエハは必須

小さいサイズでの最適化は見出せない

原石大型化の変遷



ウエハ大型化の変遷



信 頼

世界中すべてのお客様に「信頼」でお応えする
それが私たち大真空の理念です